

半導体・車載用電子部品 キュア・ベーク処理用_自動化システム

バッチ式クリーンオーブン自動化システム

- * 半導体の後工程で増加する自動化の波。
既存のオーブンの加熱特性を変えずにご提案します。
- * クリーンオーブンで材料の硬化や絶縁材封止を行うキュア、あるいはレジストの乾燥を行うソフトベーク、ハードベークなど、バッチ式で行っていた作業環境の自動化をご提案します。



特徴

- 半導体製造プロセスで要望される低酸素濃度対応、プロセス時間の短縮にご対応します。
 - ・半導体製造プロセスで要望の多い「低酸素濃度(100ppm等)」或いは「プロセス時間の短縮(チラーによる温度降下時間短縮)」などの機能により、お客様の要望に沿ったプロセスを実現します。
- 上位パソコンとの通信、前後工程の自動搬送 AGVやAMRとも連携します。
 - ・扉自動開閉、自動搬送機構(AGV、AMR、モバイルマニピュレータ等)やワーク自動挿抜との連携、温度データ取得・読み出しなど、を受けた自動化の仕組みをご提供します。
- スライド式自動扉仕様を採用し、ロボットのハンドリング考慮して高精度な位置決めが可能です。
 - ・オーブンとロボットのハンドリングの距離を最短に設置し、オーバーハングを考慮してワークを高精度に位置決めが出来ます。

アプリケーション事例

項目	仕様	
主な諸元	方式	強制熱風循環・換気方式
	温度性能	RT+60℃~+200℃
	内法	W 800 H 1000 D 700 mm
	外法	W 2300 H 2200 D 1500 mm ※突起部を含まず
機能	自動扉	左右スライド式自動扉仕様
	N2ガス供給装置(圧力・流量)	0.5~1.0MPa、300NL/min
	冷却機能(圧力・流量)	0.3~0.7MPa、10L/min
	通信機能・搬送機構	上位パソコン通信機能、前後工程との連携機能
	操作パネル	タッチパネルLCD
ユーティリティ	電源、エア	AC200V 3φ 50/60Hz、圧縮空気

エスペックサーマルテックシステム株式会社

本社 住所：埼玉県戸田市美女木東1-2-15
 TEL：048-423-1800 FAX：048-423-1801
神戸事業所 住所：兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-13
 TEL：078-856-5181 FAX：078-856-5186

製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 イラストはイメージ図です。詳細・仕様はお問い合わせください。